タツモ株式会社 決算説明資料

2021年12月期第2四半期

2021年8月6日発表 タツモ株式会社



社名 タツモ株式会社

設立 1972年(昭和47年)2月26日

本社所在地 岡山県岡山市北区芳賀5311

資本金 27億2,406万7,238円

従業員数 単体 360名/連結 1,096名(2021年6月30日現在)

事業内容 半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、液晶製造装置、

紫外線照射装置、めつき処理装置、精密金型・樹脂成型品

などの開発・製造・販売



1972	電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
1980	インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
	半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
1989	液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
1990	本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
	スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
1994	エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
1995	インジェクション成形品の製造・販売を開始
2001	半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
2004	JASDAQ市場に株式を上場
2008	TAZMO VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム:ホーチミン市)を設立

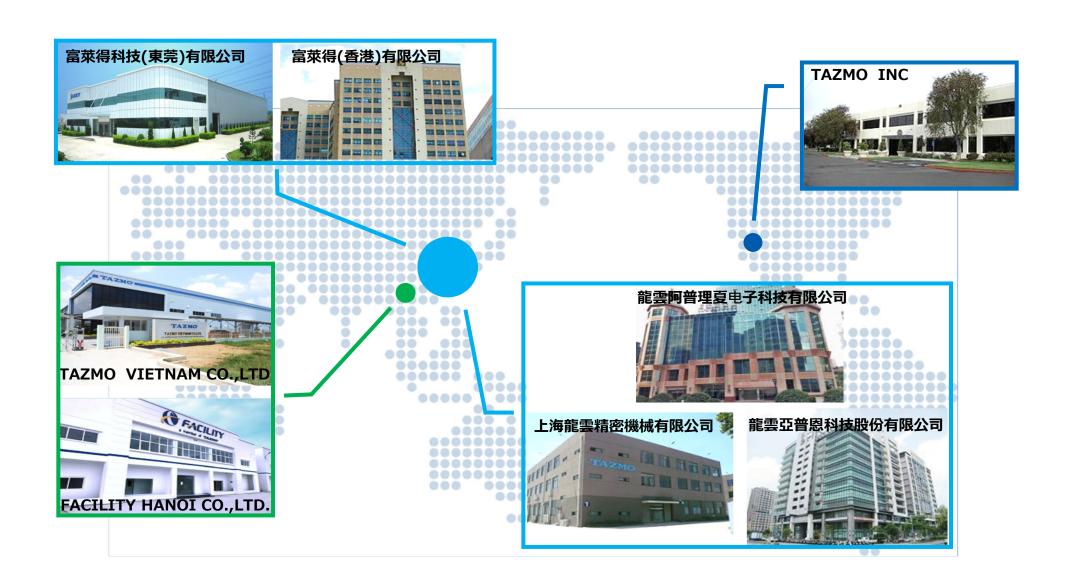


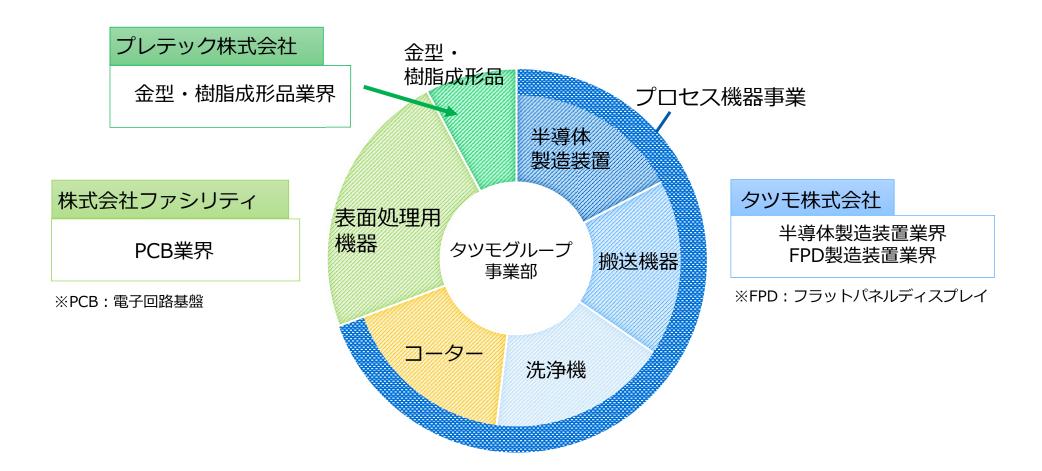
2009	第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
	3 M社(米国)と半導体製造装置のライセンス契約を締結
2013	アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
	ロンアン省ロンパウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
2015	第三者割当増資により、資本金16億1,683万円へ増資
2016	タツモ岡山技術センターを開設
2017	株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化
2018	東京証券取引所市場第一部へ市場変更
	新株式発行により、資本金27億2,406万円へ増資
2019	本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
2020	アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併











半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、 シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを 仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売









搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェー八等搬送ロボットや アライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した 製品等の開発・製造・販売

洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、 スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売







コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発・製造・販売





金型·樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使った コネクター等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売





表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の 開発・製造・販売

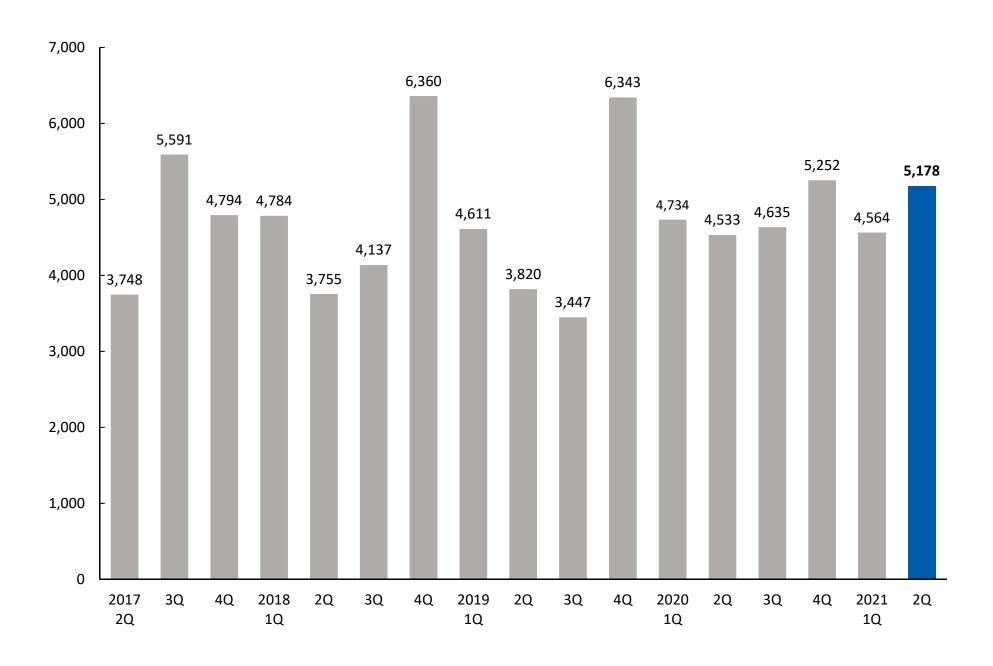


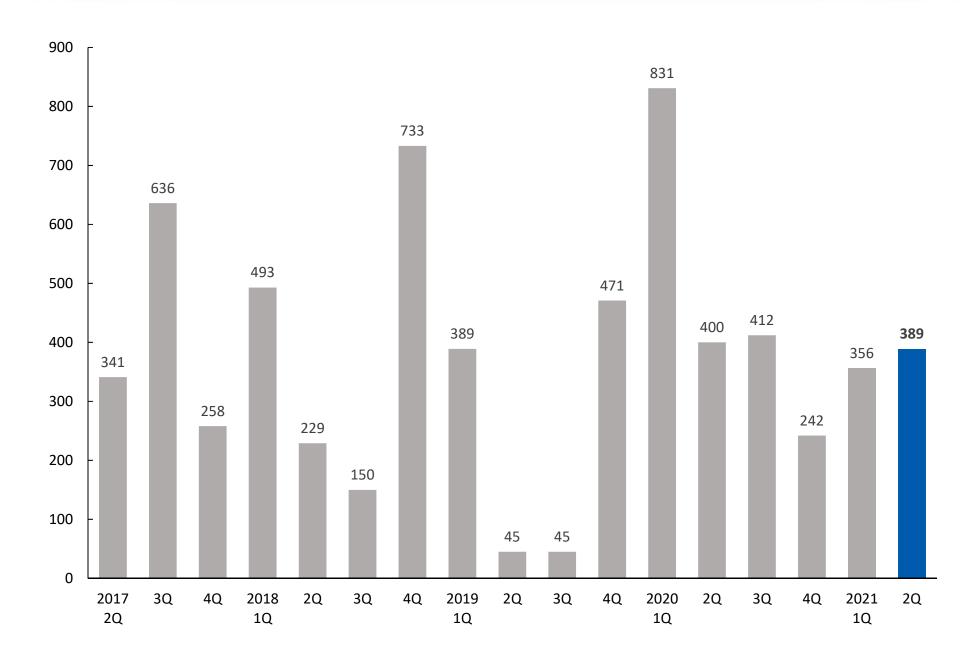


単位:百万円			′20年 2Q	′21年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (修正後通期)	達成率 (%)	
売	1	<u>-</u>	高	9,268	9,742	_	22,749	42.8
売	上総	念 利	益	2,895	2,581	26.5	_	_
販	管		費	1,663	1,835	18.8	_	_
営	業	利	益	1,231	746	7.7	2,105	35.4
経	常	利	益	1,209	821	8.4	2,160	38.0
••	社株主 半 期	に帰属 純 利		891	552	5.7	1,553	35.5

受注から売上計上までの期間が短い搬送装置部門の売上が堅調に推移し、売上高は年初計画より上回る結果となりました。

売上製品ミックスの変動により前年同期比で利益率は低下したが、原価低減活動の効果により利益も年初計画を上回る結果となりました。

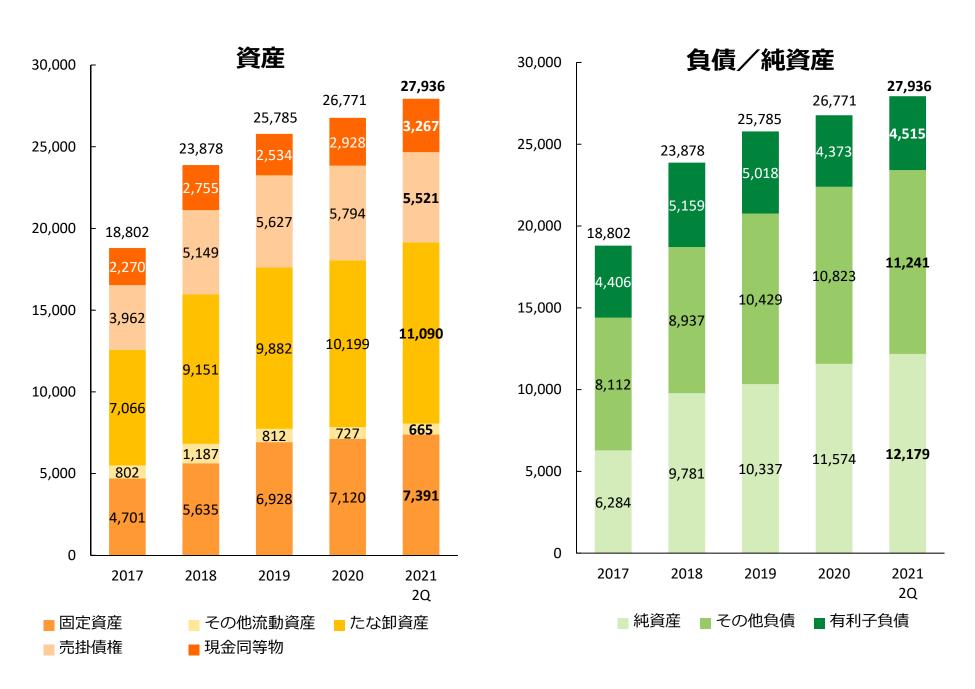




単位:百万円	′20年12月期	'21年2Q	増減
流動資産	19,650	20,545	894
有形固定資産	5,788	5,857	69
無形固定資産	171	163	△8
投資その他資産	1,160	1,370	210
総 資 産	26,771	27,936	1,165
流動負債	12,154	13,204	1,050
固定負債	3,042	2,552	△490
純 資 産	11,574	12,179	605
自己資本比率	42.6%	42.9%	0.3P

主な増減					
	'21年2Q	前期末比			
現金及び預金	3,267	338			
受取手形及び売掛金	3,874	460			
電子記録債権	1,646	△734			
たな卸資産	11,090	891			
	負債				
	'21年2Q	前期末比			
支払手形及び買掛金	1,562	107			
1年内償還予定の社債	300	300			
短期借入金	2,346	297			
前受金	5,044	334			
長期借入金	1,869	△156			





単位:百万円	′20年 2Q	′21年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (修正後通期)	達成率 (%)
売上高	9,268	9,742	_	22,749	42.8
プロセス機器事業	7,278	7,416	76.1	16,912	43.8
半導体装置	2,114	1,595	16.3	4,884	32.6
搬送機器	2,551	2,772	28.4	5,289	52.4
洗浄機	1,646	1,283	13.1	2,564	50.0
コーター	965	1,765	18.1	4,173	42.2
金型・樹脂成形事業	728	763	7.8	1,523	50.0
表面処理用機器事業	1,261	1,562	16.0	4,313	36.2

半導体装置:上期売上予定案件が少なかったため、前年同期比で24.5%減

搬送機器 : 引き続き受注好調 ベトナム子会社も好調に推移 前年同期比8.6%増

洗浄機 : ユーザーからの検収の遅れがでており、前年同期比22.1%減

コーター: '20年未検収分の売上計上により、前年同期比82.9%増

単位:百万円	′20年 2Q	′21年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (修正後通期)	達成率 (%)
営業利益	1,231	746	7.7	2,105	35.4
プロセス機器事業	1,197	656	6.7	1,711	38.3
金型・樹脂成形事業	34	53	0.6	86	61.6
表面処理用機器事業	△7	40	0.4	307	13.0
セグメント間連結消去	6	△4	_	_	_

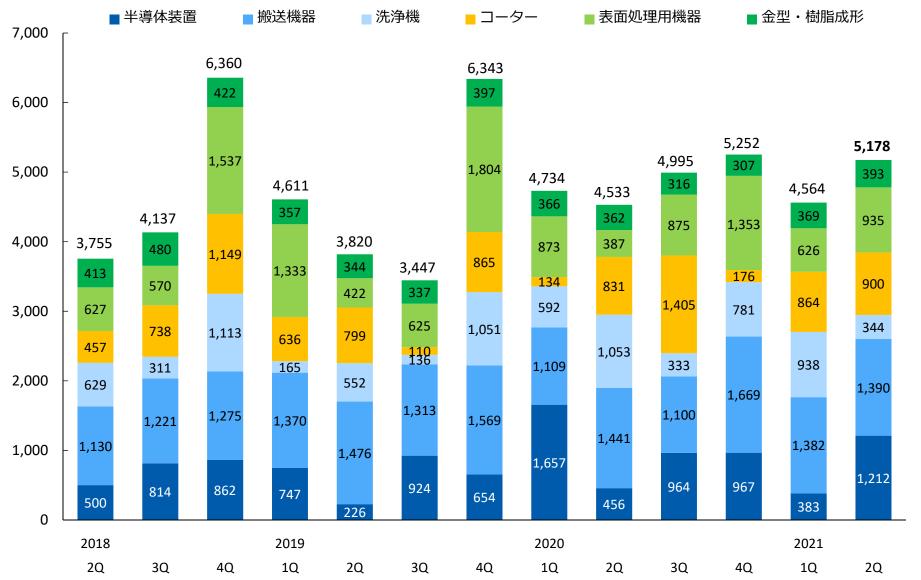
プロセス機器事業 : 半導体装置の売上減少により利益率が低下 前年同期比45.2%減

金型・樹脂成形事業:コネクター成形が好調 上海子会社のコネクター組立回復 前年同期

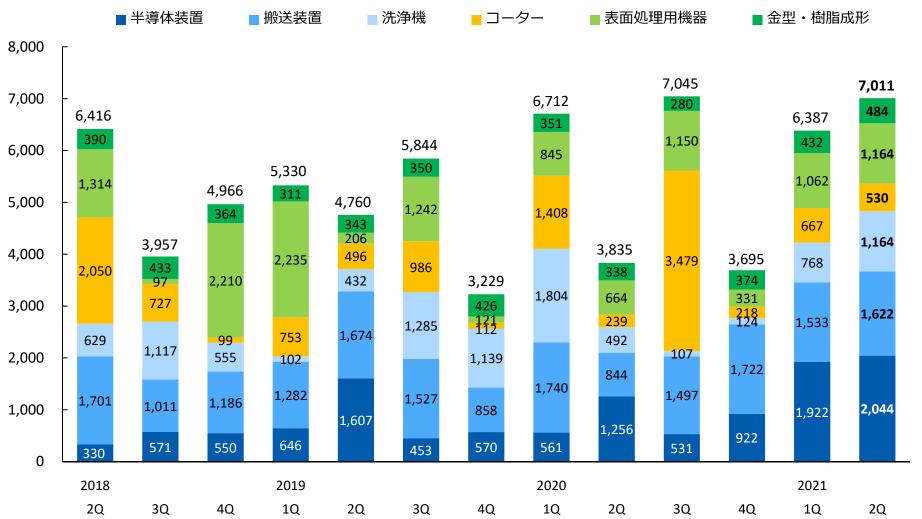
比55.9%增

表面処理用機器事業:プリント基板メーカーの設備投資が回復傾向にあり 黒字化







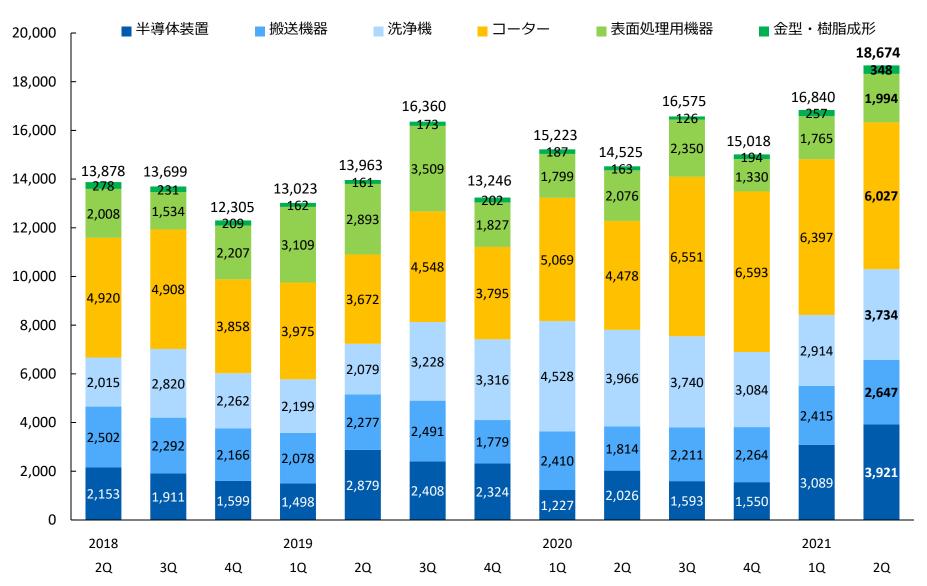


プロセス機器事業 : 半導体装置・搬送機器の受注好調。

表面処理用機器事業:引合・受注が回復傾向。

金型・樹脂成形事業:コネクター関係の受注好調。





- ▶ 半導体装置は台湾OSAT向けコーター/デベロッパの大口引合いあり。
- ▶ 搬送機器は引続き受注好調。工程管理を強化し対応。
- ▶ ナノインプリント量産用デモ機の出荷間近。
- ▶ 洗浄機で大口引合いあり。確実に受注するべく生産計画・工程管理を徹底。
- ▶ 金型・樹脂成形でもコネクターの需要は引続き好調であるが、樹脂材料の調達が困難であり生産計画が立てにくい。
- ▶ 表面処理用機器は引合が回復傾向にあり、確実な受注を目指す。
- ▶ 全部門で部品・材料の入手が難しくなってきている。今期の業績への影響は少ないとみているが、来期の出荷や今後の受注への影響が懸念される。
- ベトナムでのコロナ感染拡大により、250名の社員が会社へ寝泊まりして対応中。

本資料の取扱上の注意

本資料は、2021年8月6日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて 作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合 があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載された内容に基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

TEL 086-239-5000

FAX 086-239-5100

Email keiki@tazmo.co.jp



TAZMO